

第 143 回研究会

2015 年度精密工学会秋季大会学術講演会 オーガナイズドセッション「プラナリゼーション CMP とその応用」

開催場所: 東北大学 川内北キャンパス

(OS) プラナリゼーション CMP とその応用(1)

9月4日 9:00~10:20 H室

H01

グリーンデバイス用結晶基板の加工プロセス技術の研究開発 (第 9 報) -ダイラタンシー・パッドを用いた SiC 基板の加工品質評価-

○山崎 努・瀬下 清・塚本敬一・大坪正徳・西澤秀明 (九州大) ・宮下忠一 (不二越機械工業) ・高木正孝 (フジボウ愛媛) ・土肥俊郎 (九州大)

H02

グリーンデバイス用結晶基板加工プロセス技術の研究開発 (第 10 報) -高能率・高品位を実現するスマート加工を支えるダイラタンシー材料の物性評価法-

○瀬下 清・土肥俊郎・山崎 努・大坪正徳・塚本敬一・村上 幸 (九州大) ・佐伯 卓 (フジボウ愛媛)

H03

触媒表面基準エッチング法における触媒機能活性化手法の開発

○藤 大雪・磯橋 藍・稲田辰昭・中平雄太・松山智至・佐野泰久・山内和人 (大阪大)

H04

水酸化フラーレン混合スラリーにおける研磨微粒子の挙動観察-材料除去メカニズムに関する考察-

○村川 渉・鬼木喬玄・カチョーンルンルアンパナート・鈴木恵友 (九工大)

(OS) プラナリゼーション CMP とその応用(2)

9月4日 10:40~12:00 H室

H06

蛍光偏光法を用いた CMP スラリーの粘性係数測定による砥粒拡散現象評価

○世利俊樹・林 照剛・黒河周平 (九州大)

H07

CMP スラリーろ過における多孔質膜フィルター閉塞に及ぼす流量の影響

○角屋正人 (日本ポール)

H08

高圧ジェットを用いた CMP 用ソフトパッド表面の洗浄効果

○徳元勇太・北村 将・黒河周平・林 照剛 (九州大) ・和田雄高・檜山浩國・高東智佳子 (荏原製作所)

H09

研磨パッド表面性状に及ぼす研磨パッド表面温度並びに乾燥・湿潤状態の影響

○冨家勇一・畠田道雄（金沢工大） ・堀田和利・玉井一誠・森永 均（フジミンコーポレーテッド） ・石川憲一（金沢工大）

(OS) プラナリゼーション CMP とその応用(3)

9月4日 13:00~14:40 H室

H13

フェムト秒レーザーを用いた半導体ウェハ表面のコヒーレントフォノン励起加工に関する研究（第2報）ー加工エネルギー閾値の検討ー

○林 照剛・横尾英昭・王 成武・松川洋二・黒河周平（九州大）

H14

サファイア基板研磨用スラリーのリサイクル性能に関する研究

○大藤 健・太田慶治・松下隆幸・山崎智基・江澤俊二（ニッタ・ハース）

H15

革新的 CMP/P-CVM 融合装置の設計・試作（第8報）ー基本型装置（A型）によるダイヤモンド加工の基礎検討ー

○佐野泰久・塩澤昂祐（大阪大） ・土肥俊郎・黒河周平（九州大） ・曾田英雄・大山幸希（九州大, 並木精密宝石） ・宮下忠一・住澤春男（不二越機械工業） ・山内和人（大阪大）

H16

革新的 “Plasma fusion CMP 装置”の設計・試作（第9報）ーダイヤモンド単結晶基板の加工特性ー

○西澤秀明（九州大） ・大山幸希（九州大, 並木精密宝石） ・土肥俊郎（九州大） ・曾田英雄（九州大, 並木精密宝石） ・金聖祐（並木精密宝石） ・佐野泰久（大阪大） ・黒河周平・王 成武（九州大）

H17

CMP 中における材料除去現象に関する研究ー透明パッドによる微粒子の挙動観察ー

鬼木喬玄・○鈴木恵友・カチョーンルンルアンパナート（九工大）